

## BPC-7960

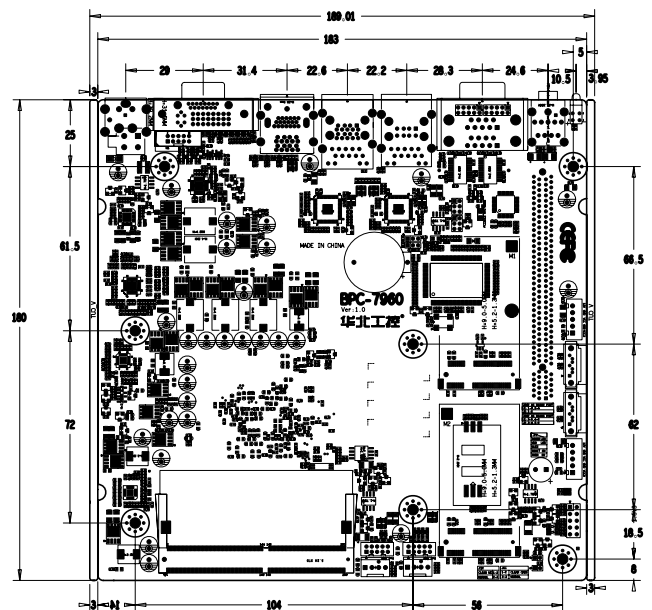
基于Intel Skylake-U Processor嵌入式工业主板



### 产品特点:

- ◆ 基于Intel Skylake-U Processor 14nm BGA1356
- ◆ 1条SO-DIMM插槽, 支持DDR4-1866/2133MHz, 最大支持8GB
- ◆ 支持VGA, DVI, HDMI显示接口, 支持独立三显
- ◆ 提供: 2x COM, 2x SATA3.0, 6 x USB2.0, 4x USB3.0, 2x LAN, 支持1x Mic\_in,1x Line\_out
- ◆ 扩展接口: 2x Mini-PCIE, 1x SIM卡槽, 1x PCIE X16 (支持2x PCIE X1、1x PCIE X4, 非标准接口), 1x LPC(可扩展多串口)
- ◆ 主板尺寸: 183mmx 180mm

### 产品尺寸图:



### 产品规格:

- ◆ CPU  
Intel Skylake-U Processor 14nm BGA1356
- ◆ 芯片组  
---
- ◆ 内存  
1条SO-DIMM插槽, 支持DDR4-1866/2133MHz, 最大支持8GB
- ◆ BIOS  
64M bit SPI BIOS
- ◆ Super I/O  
Winbond W83627DHG
- ◆ 以太网  
2x 100/1000M网卡, INTEL I211
- ◆ 图形控制器  
处理器内嵌GPU
- ◆ 显示接口  
1个VGA接口, 支持分辨率1920x1200@60Hz;  
1个DVI接口, 支持分辨率2560x1600 @60Hz;  
1个HDMI接口, 支持分辨率2560x1600 @60Hz; 支持独立三显
- ◆ 音频  
ALC662-VD0, 1XMic\_in,1XLINE\_OUT; 双层AUDIO座
- ◆ I/O接口  
2x SATAIII  
4x USB3.0, 6 x USB2.0 KB/MS(插针)  
2x COM (COM1支持RS232; COM2支持RS232/RS485)
- ◆ 扩展接口  
2个MINI PCIe插槽,1个支持Mini-PCIE/3G/4G无线网卡可选, 1个支持MSATA;  
1个SIM卡槽; 支持3G/4G模块;  
1个PCIE\*16接口 (支持2x PCIE X1、1x PCIE X4, 非标准接口);  
1个2.54mm 2x5PIN JFP;  
1个2X15PIN 2.0mm LPC接口, 可扩展多串口
- ◆ 看门狗  
Super I/O, 支持硬件复位功能
- ◆ GPIO  
8x GPIO
- ◆ 电源类型  
支持单电源+12V供电, 支持硬件及软件来电自启动功能
- ◆ 温度  
工作温度: 0°C~60°C  
存储温度: -40°C~80°C
- ◆ 湿度  
5%~95%相对湿度, 无冷凝
- ◆ 尺寸  
183mmx 180mm